

平成18年5月17日

各位

会社名 東京応化工業株式会社
 代表者名 取締役社長 中村洋一
 コード番号 4186 (東証第一部)
 問合せ先 広報部
 TEL. 044-435-3000

東京応化工業グループ中期計画についてのお知らせ

～第3次「tokチャレンジ21」～
 (平成19年3月期～平成21年3月期)

当社は、平成18年度(平成19年3月期)から平成20年度(平成21年3月期)までの中期計画第3次「tokチャレンジ21」を策定いたしましたので、その概要についてお知らせいたします。

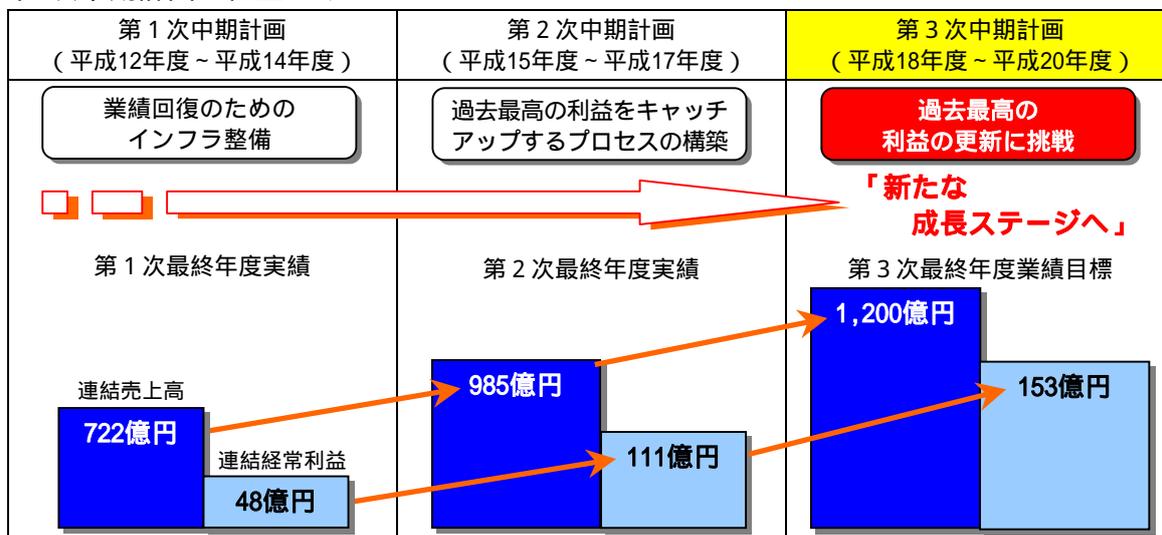
中期計画第3次「tokチャレンジ21」の概要

1. 中期計画第3次「tokチャレンジ21」策定について

本年3月まで実施してまいりました第2次中期計画(平成15年度～平成17年度)では、「過去最高の利益をキャッチアップするプロセスの構築」という課題を掲げ、グローバル市場で勝ち残る企業の実現に向けて諸施策に取り組み、一定の成果を達成いたしました。

第2次中期計画が本年3月で終了することを機に、目指すべき企業像である4つの経営ビジョンの見直しを行いました。この経営ビジョンに基づき、引き続き「高度な微細加工技術を必要とする各分野の先端領域」を事業領域とし、向後3年間において、第2次中期計画で築き上げた成果を足掛かりに、「高いCSR(企業の社会的責任)意識の下、顧客満足に徹し、技術の進化と人材開発に挑戦し、継続的に利益の出せる会社を構築する」ことに意を注ぎつつ、「企業価値の持続的な拡大への新たなステージ」へと歩を進めていくことを目標とする第3次中期計画を策定いたしました。今次中期計画の遂行を通じて、持続的な企業価値の拡大を実現しつつ、社会の進歩発展に貢献し、株主の皆様をはじめ当社ステークホルダー各位から、より高い信頼と満足を寄せられるべく、最善を尽くす所存であります。

2. 第3次中期計画の位置づけ



本件に関するお問い合わせは

東京応化工業株式会社 広報部

〒211-0012 川崎市中原区中丸子150番地 TEL.044-435-3000(代) FAX.044-435-3020

<http://www.tok.co.jp/>

3. 経営ビジョンおよび第3次中期計画の基本戦略

4つの経営ビジョンに示される企業像の実現に向け、業績、ブランド力を高め、企業の社会的責任を適切に果たすために、第3次中期計画では3つの基本戦略を策定いたしました。なお、基本戦略の遂行により、今次中期計画の期間中に平成10年3月期に計上いたしました過去最高の利益を更新することを目指しております。

(1) 経営ビジョン

- ・ CSR (企業の社会的責任)意識の高い会社
- ・ ファインケミカル分野の世界市場で、高いシェアを有し、利益率の高い製品を数多く有する会社
- ・ 収益力が高く、財務内容の健全な会社
- ・ ステークホルダーから高い信頼と満足を寄せられるブランド力のある会社

(2) 基本戦略

- ・ 微細加工技術の進化
- ・ グローバル市場でのTOKブランドの確立
- ・ 経営体質の強化・企業風土改革

4. 基本戦略

(1) 微細加工技術の進化

フォトリソ技術等の微細加工技術は、当社が長年追求してきたコアコンピタンスであり、企業価値を生み出す本源であります。第2次中期計画では、液浸露光技術における“高解像・高信頼プロセス”など新規微細加工プロセスへの研究開発を加速し、さらに半導体実装/パッケージ用材料や液晶ディスプレイ用材料“樹脂ブラックレジスト”の展開など多くの成果を挙げてまいりました。

第3次中期計画では、既存領域における優位性を堅持しつつ、市場のシーズ・ニーズを睨み、微細加工技術の枠を拡大し続ける研究開発を指向し微細加工技術の進化を推し進め、企業価値の拡大に結びつけてまいります。

成長事業領域への経営資源の集中

将来の事業展開と利益の最大化の観点から成長事業領域を見極め、経営資源の集中を図ってまいります。

新事業領域の創出

継続して事業の柱となりうる新事業領域を創造していくことは、当社グループの将来を左右するキーファクターとなります。微細加工技術の展開を図ることが可能な市場のシーズ・ニーズを的確に捉え、ニッチな分野であっても世界シェアNo.1を獲得できる新分野、新領域を開拓し、次世代に継承できるビジネスを追求してまいります。

(2) グローバル市場でのTOKブランドの確立

微細加工技術の進化を図り、企業価値の拡大に結びつけるためには、競合他社に先んじてユーザーからの要求が自然かつ必然的に当社にオファーされることが大きなアドバンテージとなります。このためにはユーザーとの強い信頼関係に裏付けられた「ブランド力」が必要であり、以下の方針により、強固な「TOKブランド」の確立を目指してまいります。

世界No.1の半導体フォトレジスト事業を生かした既存の他分野への展開

半導体製造分野での最先端技術に対する研究開発は、微細加工技術の進化に欠くことのできない最重要領域と認識し、当社の微細加工技術力を誇示する「フラッグシップ」と考えております。今後もこの領域における戦略的な研究開発に取り組むとともに、開発した新技術を他の分野へ展開していくことで、微細加工技術における確固たる優位性を築いてまいります。

顧客満足の徹底

これまで培ってきた微細加工技術におけるノウハウを最大限に活用・運用することで、品質、技術サポート、価格および物流等のすべての要素において、より一層の顧客満足の向上を目指してまいります。

海外拠点の充実

これまで整備してきた海外の各拠点において、その機能と役割を最大限に果たしていくとともに、当社を核にグループ内の連携を密にし、効率的に機能させることで、グローバル市場で「TOKブランド」を確立してまいります。

(3) 経営体質の強化・企業風土改革

「部分最適から全体最適へ」を念頭に置き、第2次中期計画で確立した経営基盤のさらなる強化を図ってまいります。また、多様化するステークホルダーからの要請に応えるべく、全社を挙げてCSRへの取り組みを推進し、企業価値の拡大を目指します。

- ・ CSR 経営の推進
- ・ 内部統制システムの構築
- ・ ITシステムの有効活用

また、企業風土についても、経営体質の根幹を成すものとして「常に危機感と夢を持ち続け、現状に満足することなく、環境の変化に柔軟に対応できる人材の育成と組織の実現に挑戦する」をスローガンに掲げ、全社一丸となって激変する環境に対応できる企業風土を醸成することを目標とします。

5. 事業別の重点活動方針

(1) 電子材料事業

当社のコア事業として、その製品の拡販を最優先課題と位置づけ、積極的な経営資源の投入を継続することで、ArFエキシマレーザー液浸用フォトレジストおよび関連材料の開発を加速させ、その技術の優位性を確固たるものとし、KrFエキシマレーザープロセス以降の先端分野において製品の拡充とさらなるシェア拡大を図ります。

(2) 液晶材料事業

製品開発のスピードアップと価格対応力の強化に加え、国内外における安定した生産・供給体制の構築により競争力を強化し、さらなる事業の躍進を目指します。

(3) PDPパッケージング材料事業

市場ニーズを的確に把握し、プラズマディスプレイ製造用材料の充実を図るとともに、半導体実装/パッケージ用材料においてもこれまで培ってきた多様な技術の応用と進化により、新規分野の開拓を指向します。

(4) 印刷化材事業

原価管理の徹底等による利益率改善を優先課題として、安定した収益確保を目指すとともに製品ラインナップの強化を行います。

(5) 装置事業

液晶パネル製造装置を事業の中心と位置づけ収益性の向上を図るとともに、微細加工技術の領域における新規用途の開拓にも取り組み、材料と装置双方を手掛ける当社の強みを発揮できるM & E (Materials & Equipment) 戦略を推進していきます。

6. 業績目標

(1) 連結業績の実績と最終年度の数値目標

(連結)

(単位：百万円・%)

	平成17年度 実績	平成20年度 最終年度目標		
			増減	増減率
売上高	98,514	120,000	+21,486	+21.8
営業利益	10,544	15,000	+4,456	+42.2
経常利益	11,156	15,300	+4,144	+37.1
当期純利益	6,656	9,100	+2,444	+36.7
経常利益率	11.3%	12.8%	+1.5ポイント	

(2) 設備投資・研究開発費・減価償却費の実績および計画

(連結)

(単位：百万円・%)

	第2次中期計画 (平成15年度～ 平成17年度実績)	第3次中期計画 (平成18年度～ 平成20年度計画)	増減額
設備投資	14,724	24,200	+9,476
研究開発費	18,227	23,300	+5,073
減価償却費	16,907	19,800	+2,893

以上

本資料に記載されている将来に対する見通し、予想等につきましては、作成時点までに入手可能な情報から得られた当社の判断に基づいており、実際には様々な重要な要因によりこの見通し、予想等とは異なる結果となる可能性があるため、この見通し、予想等のみに全面的に依拠されません様、お願いいたします。